



## 软质芯片切割机（刀）

PDMS 等软质芯片常规加工方法是浇注，受限于硅模板和容器的外圆形状，以及目标芯片的尺寸，通常在加工之后需要对芯片进行切割，为了方便切割，并减小切割对芯片的影响，目前提供三种软质芯片切割机（刀），具体情况如下：

### 软质芯片切割刀 (WH-CF-09)

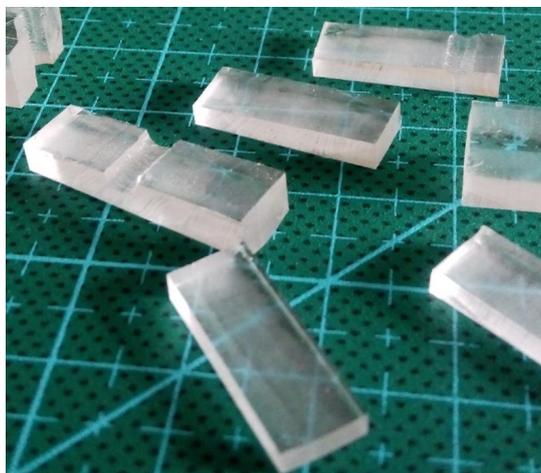


产品如上图所示，相较于普通实验室使用的手术刀，该款产品切割芯片边缘更齐，切割更省力，操作更方便，而且刀头可以更换。

### PDMS 切割机（A6）（WH-CF-10）

该款产品将刀头固定在台式打孔器上，刀头高度可调节，按压手柄可实现垂直裁切芯片。





- 1) 采用这种方法进行裁切垂直度较高；
- 2) 机器较重按手柄时比较稳；
- 3) 直接加个裁切头改装台式打孔器，实现台式打孔器的多功能。

## PDMS 切割机 (A5) (WH-CF-11)

相较于小幅面产品 A6 的切割幅面，开发了 A5 幅面的切割刀，操作原理和上述产品类似，产品结构见下图。



采用这种方法裁切 PDMS 芯片时，对准较方便。  
由于轴的晃动，裁切 PDMS 芯片时，垂直度不好。